

KYOCERA KE-850SP

Ероху; Epoxide

KYOCERA Chemical Corporation

Описание материалов:

Developed for Power Device Package that needs Good Heat Dissipation Through Molding Compound.

Strong Points

High Thermal Conductivity with Good Moldability, Excellent Moisture Resistance and Low Stress.

Used in Auto Molding System by Rapid Cure Grades.

KE-870 and KE-880 is Formulated with Special High Thermal Conductivity Filler System and Achieve High Thermal Conductivity (above 3W/m K).

Application

Isolation Packages such as TO-220 and TO-3P that need Heat Dissipation Characteristics.

Packages for High Heating Volume such as Power Module.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая плавность Влагостойкий Теплопроводящий	
Используется	Электрическое/электронное применение	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.19	g/cm ³
Spiral Flow	50.0	cm
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	190	°C
CLTE-Поток		
-- 1	2.1E-5	cm/cm/°C
-- 2	5.9E-5	cm/cm/°C
Теплопроводность	2.3	W/m/K
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time	0.58	min
NOTE		
1.	Alpha 1	
2.	Alpha 2	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

